# 附件1

# 产品认证申请书

项目编号：

（认证标志）

**通信器件芯片产品认证申请书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 申请日期 |  |
| 联系地址 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | E-mail |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 样品名称 |  | 样品标识 |  |
| 样品分类 | □射频器件 □光通信器件 |
| 认证模式 | □模式A □模式B | 应用领域 |  |
| 典型客户 |  |
| 应用案例介绍 |  |
| 该器件芯片销售额 |  | 推出时间 |  |
| 申请器件芯片的实施产权归属 | □属于申请单位□其他： （请注明） | 封装厂 |  |
| 封装工艺 |  |
| 代工厂 |  |
| 生产工艺 |  |
| 器件芯片企业基本情况介绍 | （注：成立年限、企业规模、上一年经营状况、通过质量体系情况等） |
| 样品简介 | （注：基本功能、指标、其他领域应用、知识产权专利，并可以列出产品执行的国际、国家、行业技术标准等） |
| 器件芯片应用方案 |  |
| 器件芯片结构图 |  |
| 通过哪类品质认证或测试 |  |
| 法人/授权代表签字：企业（盖章）日期：  |